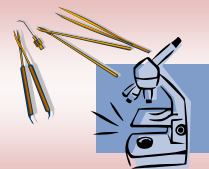




第18回 新技術説明会(キャラバン隊)

— これからの表面処理技術 —



4uおよび連携機関の技術やその活用例等についてご紹介し、地域産業の高度化と活性化につながるよう技術移転の推進や共同研究の開拓を目指すマッチングイベント「4u新技術説明会(キャラバン隊)」を開催します。今回は、(公財)茨城県中小企業振興公社と茨城県工業技術センターにご協力いただき、素材加工の高付加価値化に寄与する「表面処理技術」について取り上げることにいたしました。金属・合金・樹脂などの各種素材における研磨・メッキ・溶射(吹き付け)・コーティング、またそのために必要な処理等に関する説明と相談を行います。ご多忙のところ恐縮ではございますが、是非ともご参加下さいませようご案内申し上げます。

◆日時：2013年8月20日(火)13:00~18:15

◆場所：茨城県工業技術センター ※受付 12:30~

〒311-3116 茨城県東茨城郡茨城町長岡 3781-1

◆参加費：無料

※情報交換会(名刺交換&相談&交流会)のみ有料 1人500円

◆対象：中小企業、支援機関、大学(教職員・学生)等関係者

◆募集定員：85名(センター見学20名) ※事前申込制

◆主催：首都圏北部4大学連合(4u:茨城大学・宇都宮大学・埼玉大学・群馬大学)、茨城県工業技術センター、首都圏北部地域産業活性化協議会(特定非営利活動法人北関東産官学研究会・茨城県・栃木県・群馬県・(株)ひたちなかテクノセンター・(公財)栃木県産業振興センター)

◆後援：経済産業省関東経済産業局、埼玉県、さいたま市、(公財)茨城県中小企業振興公社、(公財)群馬県産業支援機構、(公財)埼玉県産業振興公社、(公財)日立地区産業支援センター、常陽銀行、筑波銀行、群馬銀行、東和銀行、足利銀行、栃木銀行、埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、水戸信用金庫、結城信用金庫、埼玉縣信用金庫



- タクシー：JR常磐線水戸駅南口より約20分
- バス：JR常磐線水戸駅北口より3番のりば「免許センター行き」警察学校前下車にて徒歩1分
- 高速道路：北関東自動車道 茨城町東ICより約3分

◆本件に関する問合せは、茨城大学 産学官連携イノベーション創成機構 友田(和) または 大谷 までお願いいたします。

TEL：0294-38-5057、 FAX：0294-38-5240、 e-mail: 4u@ml.ibaraki.ac.jp http://www.rd.ibaraki.ac.jp/

----- (お申し込み：下欄に必要事項を記入し、FAX または e-mail 送信をお願い致します) -----

FAX：0294-38-5240 e-mail：4u@ml.ibaraki.ac.jp

茨城大学 産学官連携イノベーション創成機構(4u担当)行

※申込期限 8月12日(月)



◆参加申込書

所属(貴社名) _____ 業種 _____ TEL _____

住所 _____ ご紹介元 _____

参加者氏名			
部課署・役職			
e-mail			
【第1部】工業技術センター見学会	参加 ・ 不参加 (いずれかに○を記入)	【第3部】情報交換会	参加 ・ 不参加 (いずれかに○を記入)
【通信欄・個別相談】各先生の発表後に個別相談を行います。個別相談希望の方は相談希望先に○をし相談内容をご記入下さい。 ※相談1件15分程	【個別相談希望機関：茨城大学・宇都宮大学・埼玉大学・群馬大学・茨城県工業技術センター】		

※別途相談希望の方は情報交換会で発表者等と名刺をご交換下さい。ご記入いただいた内容は首都圏北部4大学連合(4u)の事業に際してのみ利用いたします。

◆4u 新技術説明会プログラム◆

【第1部】 茨城県工業技術センター見学会 13:00～13:50 ※先着20名、希望者のみ、事前申込制

2組にわかれ、表面粗さ輪郭形状測定機、3次元測定装置、微小ビッカース硬さ試験機、EMC設備(EMI機器)、摩擦攪拌接合機(FSW)、ラマン分光分析装置を見学します。その後、各機器についてセンター職員が詳しく説明・実演等を行います(それぞれ関心ある装置のある研究室に移動)。センターの各機器は、企業の皆様が分析を依頼したり、自分で動かして測定することができる装置ですので、この機会に、どのようなものがあり何ができるのかをご覧くださいと思います。
※見学会は申込定員に達し次第締め切らせていただきます。また、茨城大学産学官連携イノベーション創成機構ホームページでもご案内いたします。

【第2部】 研究技術発表会(発表は1件につき発表25分、質疑応答5分) 14:00～17:00

●主催者挨拶 ①茨城大学 ②茨城県工業技術センター ③北関東産官学研究会

※発表の順番、内容は変更になる場合があります。

1	14:15～14:45	「超精密ハイブリット加工プロセス」 群馬大学 理工学研究院 知能機械創製部門 准教授 林 偉民	リン イミン
	<p>本研究では次世代光学素子の加工法の検討として、切削、研削、研磨などいくつかの超精密加工プロセスを併用し、それらの加工法の相乗効果を見出し、加工プロセス全体を最適化する超精密連携加工プロセスの提案およびその基礎研究を進めています。トータルプロセスの考えもとでそれぞれ分断している既存技術を組み合わせ、一つの加工プロセスとして連携し、製造の高精度・高効率を目指します。超精密加工・計測技術、マイクロ形状加工、金型加工、研磨加工、ELID研削、自動車部品加工、生産管理などのご相談も可能です。</p> <p>【想定される用途】超精密光学素子やその金型の製造、各種光学測定・分析機器の光学系に使用するレンズ、ミラーや天文宇宙観測用機器の光学系など。</p>		
2	14:45～15:15	「磁気加工技術とその応用」 宇都宮大学 工学研究科循環生産研究部門機械知能工学専攻 准教授 郷 艶華	シュウ エンカ
	<p>磁気加工は機械加工と磁力を組み合わせた新しい加工技術です。従来の加工技術が困難であった箇所、例えば、複雑形状曲がり管の内面加工、管内面の磁気バリ取りなどに有効で、通常の工具が入らない箇所を研磨加工することが可能です。特徴として、1. 従来技術の問題点であった各種部品の内面加工と内面バリ取りを実現できる、2. 手作業に依存していた内面の精密バリ取り作業を機械化・自動化できる、3. 永久磁石と鉄粉を使用することからバリ取りコストが極めて低く抑えられる等があります。半導体、ハイテク産業、医療機器、バイオテクノロジー分野からのご相談も可能です。</p> <p>【想定される用途】1. 各種非磁性材部品の内面加工、内面バリ取りに適用することによって本技術の特徴が生かされる。2. 用途として、丸パイプの内面バリ取り、角パイプ内面のバリ取り、各種精密機械部品内面のバリ取りに適用できる。3. 平面、曲面の精密仕上げも適用できると考えられる。</p>		
3	15:15～15:45	「半導体・光学デバイスの鏡面研削加工」 埼玉大学 大学院理工学研究科 人間支援・生産科学部門 助教 澁谷 秀雄	シブタニ ヒデオ
	<p>半導体、光学デバイスには無擾乱鏡面が必要不可欠です。一般的にこれらは研磨加工によって創成されていますが、これは高い技能と長い時間を必要とします。また、使用後の研磨液の処理など環境への配慮も必要です。これら課題を解決する方法として、超精密研削加工による鏡面創成に注目し鏡面研削用砥石の開発を行っています。これまでに開発した砥石を用いることで、乾式雰囲気下で8インチシリコンウエハや3インチ水晶ウエハ全面を焼けやスクラッチのない表面粗さ10nmRzの鏡面に仕上げること、3インチ石英ガラスウエハも表面粗さ数nmRzの鏡面に仕上げることができることを可能としています。メカノケミカル反応を有する微粒子を電気泳動現象で固定化するため、非常に均質で自生発刃特性に優れています。研磨加工する工程の研削加工への置き換え・研削加工全般に関する生産性や品質向上などのご相談が可能です。</p> <p>【想定される用途】シリコン、水晶、サファイア、SiC、光学ガラス基板の鏡面創成、球面・非球面形状の鏡面創成など</p>		
4	15:55～16:25	「高分子材料へのダイヤモンドライクカーボン(DLC)膜の成膜とその応用」 茨城大学 工学部 機械工学領域 准教授 尾関 和秀	オセキ カズヒデ
	<p>潤滑性、耐摩耗性、ガスバリア性、生体適合性に優れるダイヤモンドライクカーボン(DLC)膜は、現在、金属を中心とする機械部品に多く用いられています。今回は、DLC膜の一般的性質に加え、これまでのような金属に用いる際の例ではなく、樹脂など、高分子にコーティングする場合の課題について紹介し、更にコーティングの応用例として、消臭性を目的としたDLC/TiO₂薄膜について紹介します。技術の特徴としては、DLCとTiO₂膜を組み合わせることでプラスチック製品に使用することで、防臭と消臭が可能となります。</p> <p>【想定される用途】食品容器、ペット関連商品等、臭いが吸着するプラスチック製品、生体適合性を求める高分子材料のコーティング剤など。</p>		
5	16:25～16:55	「マイクロ・ナノバブルを利用した半導体ウエハ洗浄技術の開発」 茨城県工業技術センター 副センター長 小島 均	オジマ ヒトシ
	<p>マイクロ・ナノバブルは、直径50μm以下の微小気泡で、普通の気泡が水中を急上昇して破裂して消えるのに対し、気体溶解性に優れ、水中で縮小していき消滅してしまいます。水中で縮小・消滅する時にフリーラジカルを発生し、化学物質の分解性に優れています。オゾンマイクロバブル圧壊時に発生する水酸化ラジカルの強い酸化力による有害な薬剤をほとんど使用しないクリーンな洗浄技術です。この特性を利用した半導体ウエハ上のレジスト膜除去技術開発の結果を解説します。また、この研究開発を支えた産学官連携体制による活動事例を紹介いたします。</p> <p>【想定される用途】半導体ウエハ及び製造治工具の洗浄・金属表面処理(めっき 塗装)の前処理・高いクリーン度を要求される容器などの精密洗浄・オゾン併用した衣類・寝具の洗浄及び滅菌など。</p>		

●閉会挨拶 宇都宮大学(次回4u新技術説明会開催担当校)

【第3部】 情報交換会(名刺交換&相談&交流会) 17:15～18:15 ※参加費500円